OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.1 Informacje podstawowe

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu płytek elektronicznych według dokumentacji przygotowanej przez zamawiającego. Dokumentacja zawiera: nazwę elementów, ich wymiary, rodzaj materiału z jakiego mają być wykonane, klasę dokładności oraz uwagi dotyczące sposobu wykonania.

1.2 Zakres przedmiotu zamówienia

W skład przedmiotu zamówienia wchodzi 9 następujących kompletów płytek elektronicznych:

- płytki do wzmacniacza typu PIP
- płytki do wzmacniacza typu MIP
- płytki do wzmacniacza typu SIP
- płytki do wzmacniacza typu FIP
- płytki do wzmacniacza typu QIP
- płytki do wzmacniacza typu AIP
- płytki do wzmacniacza typu uIP
- płytki do kontrolera typu PTCC-BAS
- płytki do zasilacza typu PPS-03-09

Komplety w ilości po 30 sztuk płytek każdy.

1.3 Tabelaryczne zestawienie dokumentacji technicznej

Dokumentację techniczną prezentuje poniższa tabela.

	MIP	PIP	SIP	FIP	QIP	AIP	uIP	PTCC-BAS	PPS-03
Liczba obwodów PCB	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Ilość warstw PCB	4	4	2	2	4	2	4	4	2
Grubość Laminatu	1.5	1.5	0.5	0.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
Ilosć elementów biernych	71	225	51	81	198	136	30	243	28
Obudowa elementów biernych	603, 805, 1210, ACH32C, A, C, 5x4x5_44W	603, 805, 1210, 1806, B, C	603, 805, 1206, A, NFM21, 5x4x5_44W	603, 1210, 1806, A	603, 805, 1210, A, B, C	603, 805, 1206, A, B, C	603, C, 5x4x5_44W, NFM21, SMB	603, 806, 1210, C, NFM21	603, 805, A, C, TEN 8-1211, SMB
Ilosć układów scalonych	6	33	5	5	19	7	3	38	3
Obudowa układów scalonych	SO8, TO92A	SO8, SOIC127, SOIC2312, SOT23, SOT95, AQY211	SO8, TO92A	SO8, TO92A	SO8, SOT-223, SOIC127, SOIC2312, SOT23	SO8, SO16	SOT-23, SOT-25	SO8, SOIC127, SOIC2312, SOT23, TQFP80, TSOP65	SOT-263, TO-263, TEN 8-1211
Ilość złącz	-	4	2	-	5	2	2	3	3
Soldermaska	zielona	zielona	zielona	zielona	zielona	zielona	zielona	zielona	zielona
Opis Elementów	biały	biały	biały	biały	biały	biały	biały	biały	biały
Wymiary PCB (mm)	75x28	79x29	41x23	-	-	60x40	26x10	111x51	51x50
Wymiary Panelu PCB (mm)	170x160	173x74	139x144	86x59	84x50	-	-	238x118	171x168
Ilość PCB w panelu	10	4	15	1	1	-	-	4	9
Grubość miedzi	35um	35um	35um	35um	35um	35um	35um	35um	35um
Materiał	FR4	FR4	FR4	Isola/I-tera	FR4	FR4	FR4	FR4	FR4